

东芯半导体股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯股份”或“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任，进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力，维护全体股东的利益，公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 8 月 24 日制定并发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。2024 年度（以下简称“报告期”），公司积极开展和落实行动方案各项工作，取得了良好的效果，现将行动方案 2024 年度执行情况评估如下，并制定了 2025 年度的优化目标和提升举措：

一、聚焦公司主业，优化业务布局

2024 年，公司继续深耕存储芯片主业，主动适应不断变化的经营环境，持续加大技术和产品研发的投入。同时公司以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术布局，拓展行业应用领域，优化业务布局，以期为客户提供更多样化的芯片解决方案。公司高度重视自主知识产权的保护，秉承长期主义理念，坚持技术创新，致力于持续为企业、行业及社会创造更大价值。

（一）深耕主营业务，坚持技术创新

报告期内，公司继续加强 SLC NAND Flash 技术优势，积极推进存储产品的升级迭代。报告期内 1xnm 闪存产品研发及产业化项目已进入风险量产阶段。2xnm 制程持续进行 SLC NAND Flash 产品系列的研发迭代，不断扩充产品料号。

公司基于 48nm、55nm 制程，持续进行 64Mb-2Gb 的中高容量 NOR Flash 产品研发工作，根据不同容量的目标客户群进行精确定位，保证性能、功耗和性价比的合理匹配。随着公司 NOR Flash 产品持续迭代升级，产品品类不断丰富，将为可穿戴设备、安防监控、物联网、汽车电子等领域的客户提供多样化、高可靠性的产品选择。

公司在已量产的 DDR3(L)、LPDDR1、LPDDR2、PSRAM 等产品基础上，持续进行新产品的研发。公司设计研发的 LPDDR4x 产品已进入量产阶段，产品

通过小尺寸封装、低电压设计和宽温适应性，覆盖了从消费电子到工业/汽车电子的多元化场景，其技术优势在移动设备轻薄化、工业场景可靠性及 AIoT 数据处理需求中尤为突出。公司将继续在 DRAM 领域进行新产品的研发设计，拓宽 DRAM 产品线，助力公司产品多样性发展。

公司目前已可以向客户提供 4Gb+4Gb、8Gb+8Gb、16Gb+16Gb 等组合的 MCP 产品，主要应用于 5G 通讯模块、车载模块等应用领域。公司正在研发更多容量组合的 MCP 产品，通过自研 SLC NAND Flash 及 DRAM 组合出具有成本优势及性能稳定的 MCP 产品，以便为客户提供更多样化的产品选择。

报告期内，公司继续推进车规级存储产品的研发及产业化进度，打造高附加值的车规产品，公司 SLC NAND Flash、NOR Flash 以及 MCP 等产品陆续有更多料号通过 AEC-Q100 的验证，将适用于要求更为严苛的车规级应用环境。公司积极进行车规客户的导入和验证，报告期内新增完成国内多家整车厂的白名单导入，完成多家海内外一级汽车供应商（Tier1）的供应商资质导入，并已向包括境外知名的一级汽车供应商（Tier1）等进行车规产品的销售。

2025 年，公司将继续深耕存储主业，继续推进产品制程迭代，通过工艺优化与规模效应降低单位成本；继续提升产品可靠性指标，强化车规级认证布局，切入汽车电子等高附加值市场，提升产品毛利水平；积极进行产品创新，推出更多贴近客户需求的差异化产品，深度绑定高价值客户，增强客户粘性，巩固国内存储芯片市场地位。

（二）围绕存储主业，优化业务布局

报告期内，公司持续推进“存、算、联”一体化战略布局，通过技术创新、生态协同与产业链延伸，逐步构建起以存储芯片为核心，覆盖计算、通信领域的多元化技术生态体系，为公司培育了第二增长曲线，为未来增长注入新动能。

在通信/连接芯片领域，公司看到 Wi-Fi 芯片市场广阔的空间，特别是 Wi-Fi 6/7 在高带宽、高安全性、低延时以及对多设备同时接入有较高要求的场景具备明显优势，未来将成为 Wi-Fi 芯片市场增长的主要驱动力，伴随着智能手机、笔记本电脑、物联网 (IoT) 设备、智能家电和其他联网设备的使用不断增加，推动了对 Wi-Fi 芯片组的需求，并增加了对可靠、快速无线通信的需求。物联网 (IoT) 的普及导致各种应用对 Wi-Fi 芯片组的需求增加，包括可穿戴技术、智能家电、

工业自动化、医疗设备等。随着互联网连接在发展中国家的普及，对低成本 Wi-Fi 设备的需求增加，未来也将推动 Wi-Fi 芯片市场的增长。公司于报告期内设立子公司亿芯通感，完成了研发团队的组建工作，持续开展 Wi-Fi7 无线通信芯片的研发设计。首款无线透传芯片聚焦高带宽、低时延场景，可满足智能终端等领域对高速连接的需求，通过差异化创新为消费类企业客户提供本土化的智能无线通信与感知的芯片及解决方案，目前项目进展顺利。

在计算芯片领域，公司于报告期内通过自有资金 2 亿元人民币战略投资砺算科技（上海）有限公司，布局高性能 GPU 赛道。砺算科技坚持自研架构，产品可实现端、云、边的主流图形渲染和 AI 加速，对标主流 GPU 架构，与外部生态无缝兼容，力争解决国产主流完整 GPU 架构自主可控的关键问题。其自主研发的首代图形处理芯片 G100 基于自研架构，可支持主流 3A 游戏运行。G100 芯片产品已于 2025 年初进行流片。报告期内，公司已完成投资协议签署、工商变更手续、增资款的缴付，并通过委派董事及财务负责人，助力砺算科技完善公司治理、提升管理水平、更好发挥与上市公司的协同效应。

2025 年，公司将凭借多年来在行业内的资源、客户、供应链、经验等方面积累的优势，继续以存储为核心，对“存、算、联”一体化领域进行技术布局，力争在存储芯片主业之外的计算芯片、通信芯片的研发及产业化进展取得突破。另一方面，公司将积极推动与供应链上下游伙伴的紧密合作，推动产业链的共同创新与发展，公司将凭借对产业发展趋势的理解，结合公司战略规划考虑与业务发展的需要，视情况开展符合未来发展战略的投资、并购或其他战略合作。

（三）保持高水平研发投入，坚持核心技术自主可控

公司报告期内研发费用 2.13 亿元，占当期营业收入 33.27%，较上年同比增加 17.02%。报告期内，申请发明专利 18 项（其中中国发明专利 15 项，美国发明专利 1 项，PCT 国际阶段发明专利申请 2 项），获得发明专利授权 30 项（其中中国发明专利 4 项，美国发明专利 4 项，韩国发明专利 22 项）；申请集成电路布图设计权 5 项，获得集成电路布图设计权 5 项；申请注册商标 4 项；申请软件著作权 1 项，获得软件著作权 1 项。截至报告期末，公司拥有境内外有效专利 113 项、软件著作权 15 项、集成电路布图设计权 86 项、注册商标 14 项。

2025 年，公司将继续保持高水平研发投入，不断加大技术研究、产品开发

投入力度，对产品技术不断进行改进和创新，对创新成果通过专利申请等方式进行保护，不断提高公司核心竞争力。

（四）稳步推动募投项目

报告期内，公司“1xnm 闪存产品研发及产业化项目”已取得阶段性进展，产品已达成部分关键指标，但项目涉及的制造工艺复杂，并且生产验证周期较长。因此，为确保产品质量与性能稳定，后续仍需更多时间进行设计优化和工艺调试等技术攻关工作。经重新论证后，该项目继续实施仍然具备必要性和可行性。公司经审议，将该募投项目延期至 2025 年 6 月 30 日。截至报告期末，1xnm 闪存产品研发及产业化项目已进入风险量产阶段。

报告期内，公司募投项目“车规级闪存产品研发及产业化项目”，公司研发的车规级闪存产品已通过 AEC-Q100 的验证，已实现车规级闪存产品的销售；公司募投项目“研发中心建设项目”已达成预期的研发中心建设目标，其中 LPDDR4x 已完成研发并进入量产阶段。以上两个募投项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件并予以结项。

2025 年，公司将持续强化募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，科学合理使用募集资金，切实保证募投项目顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，进一步丰富公司产品种类、提升产品性能，持续强化公司的创新能力，增强公司整体盈利能力。

二、完善公司治理，提升规范运作水平

公司已按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，建立了包括股东大会、董事会、监事会和管理层组成的较为完善的公司治理结构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间的权责明确、运作规范的公司治理体系。

报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司治理的实际情况，对《东芯半导体股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》等 28 部公司治理制度进行了制定、修订。

报告期内，公司重视董事、监事、高级管理人员等“关键少数人员”的培训

工作，借助证监会、上海市证监局、上交所、中国上市公司协会、上海上市公司协会等监管部门及平台的学习资源，组织相关人员积极参加各类培训，加强证券市场相关法律法规的学习，不断强化合规意识，提升公司董监高履职能力，推动公司持续规范运作。

2025年，公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，定期自查，及时修订公司管理制度，调整及完善公司三会架构及运作机制。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，组织相关人员积极参加各类监管机构举办的各类培训，加强证券市场相关法律法规的学习，不断强化合规意识，提升公司董监高履职能力，推动公司持续规范运作。

三、加强投资者沟通，提升信息披露质量

报告期内，公司分别于2024年5月10日、2024年9月4日、2024年9月19日、2024年11月8日在上海证券交易所上证路演中心举办了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年半年度沪市半导体行业集体业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会，组织、参加了路演、反路演、策略会等共计约179场投资者交流会，并通过股东大会、上证e互动、公司网站投资者关系专栏、投资者电话与电子邮箱等各种多样化方式和渠道开展投资者沟通与交流活动，保障投资者对公司信息的全方面了解，引导投资者更好理解公司的投资价值，增强投资者对公司的信心，并认真听取投资者对公司的意见和建议，助力公司高质量发展。公司借助新媒体，从多角度向投资者传递公司文化、产品、技术、业绩等方面的信息，报告期内公司微信公众号“东芯半导体”总计发布50余篇推文，粉丝总数超过11000人。

报告期内，公司积极践行可持续发展理念，重视ESG（环境、社会责任、公司治理）对企业的重要作用，积极将ESG理念和要求融入商业模式和管理体系，注重环境保护，积极履行企业社会责任。报告期内，公司披露了2023年度环境、社会与治理（ESG）报告，对公司在上述责任领域的实践与绩效进行了汇报与总结，详见公司2024年4月20日披露的《东芯股份：2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

2025年，公司将严格遵循法律法规和监管要求，贯彻执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，将公司情况及时

有效传递给资本市场。公司将召开不少于三次（含）业绩说明会，并通过各种形式切实保证投资者对公司信息的全方面了解，遵守资本市场和半导体行业发展规律，引导投资者更好理解公司的投资价值，增强投资者对公司的信心，并认真听取投资者对公司的意见和建议，助力公司高质量发展。公司将继续做好环境、社会及公司治理（ESG）报告的披露工作，持续提升可持续发展（ESG）信息披露质量。

四、完善投资者回报机制，提升投资者信心

公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，在注重生产经营的同时，重视广大投资者的回报，通过回购等方式维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心。

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，公司于2023年5月推出第一期股份回购方案。截至2024年5月8日，公司已完成第一期股份回购，已实际回购公司股份3,218,219股，占公司总股本的0.7277%，回购最高价格38.77元/股，回购最低价格22.80元/股，回购均价31.09元/股，使用资金总额10,006.27万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

为维护公司价值及股东权益，公司于2024年7月推出第二期股份回购方案。截至2024年10月9日，公司已完成第二期股份回购，占公司总股本的1.2452%，回购最高价格20.00元/股，回购最低价格14.14元/股，回购均价18.19元/股，使用资金总额10,017.33万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，公司控股股东东方恒信集团有限公司于2024年10月推出增持东芯股份的计划，拟自2024年10月21日起6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份不低于人民币2.0亿元。截至2025年1月27日，控股股东已完成本次增持计划，自2024年10月21日至2025年1月24日期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份8,411,537股，占公司总股本1.9020%，增持金额合计人民币219,923,992.47元（不含交易费用）。

2025年，公司将继续致力于提升盈利能力，改善经营业绩，努力平衡公司发展、业绩增长与股东回报三者之间的关系。公司将始终秉持投资者为本的原则，

确保在公司长期稳定健康发展的基础上，重视对投资者的合理回报，与股东共享公司发展的成果，探索科学、合理的方式，在满足法律法规要求和公司章程规定的利润分配政策的同时，充分考虑投资者的利益，增强投资者的价值获得感。

五、重视人才培养，健全长效激励机制

公司秉持“人才优先，服务发展，使用为本”原则，构建起涵盖人才培养开发、评价选拔、流动配置、激励保障的特色培训管理体系，通过培训效果评估与反馈，确保培训成果服务于公司经营与发展，助力公司形成区域内的人才竞争优势。公司通过分层级开展培训，全力打造多元化、高质量的人才队伍。针对新员工，公司开展项目实战演练，帮助新员工快速融入公司文化与工作节奏。对于技术人员，公司以市场需求与行业技术发展为导向，为核心技术储备人才制定培养计划，通过长期技术培训、专题讲座、团队技术专家“以老带新”等方式，提升员工专业素养、增强归属感与责任意识，扩充人才储备。报告期内，公司共开展员工培训 54 场次，接受培训总计 183 人次，培训总时长 348 小时，员工培训平均时长 1.10 小时/人。

同时，公司不断完善激励、约束机制，优化薪酬体系、完善绩效考核制度，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司各管理层和核心业务（技术）骨干的积极性，增强公司凝聚力，促进公司健康长远可持续发展。为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，公司已连续三年实行股权激励计划。报告期内，公司实施了 2024 年度股权激励方案，于 2024 年 4 月公布了 2024 年限制性股票激励计划，对公司管理层及核心员工授予限制性股票。公司为上述股权激励计划设置了公司层面及个人层面的考核指标。公司选取了营业收入增长率作为公司层面的业绩考核要求，并对所有激励对象设置了个人层面的绩效考核要求，根据激励对象的年度考核结果确定激励对象是否符合归属条件。以上考核体系可以有效实现股权激励的约束作用，提升激励对象的积极性，有助于提升公司活力及发展动力，促进公司发展，增强投资者回报。

2025 年，公司将继续加大人才培养力度，进一步完善人才梯队建设，通过内部培训、外部引进等多种方式，不断提升员工的专业技能和综合素质，为公司

的持续发展提供坚实的人才保障。公司将建立更加完善的员工激励机制，继续推行常态化股权激励计划，继续严格落实股权激励计划的考核指标要求，严格执行股权激励计划实施考核管理办法，确保管理层与核心员工与公司目标一致，心系股东利益，实现风险收益共担，共同促进公司可持续健康发展，增强投资者回报。

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义。在新的一年里，公司将积极推动并落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，持续评估行动方案的执行情况，并及时履行信息披露义务。未来，公司将持续深耕主业，强化核心竞争力、提升盈利能力、提高公司治理水平，履行上市公司责任，塑造良好的市场形象，切实维护投资者利益，增强投资者信心，为股东创造更多的投资回报。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

东芯半导体股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日